

ラックスケールサーバー

FusionPoD

商用液冷の新しいベンチマーク
高密度コンピューティングパワーの新しいフラッグシップ



ラックスケールサーバー FusionPoD

概要



FusionPoD 720



DH122E V6



DH120E V7

FusionPoD 720ラックスケールサーバー（以下「FusionPoD 720」という）は、N+1集中電力供給システム、電源/ネットワーク/液体の3バス設計、ノードのブラインドメイティングを含む、最先端の統合キャビネット設計を採用しています。キャビネット全体0ケーブル対応により容易な運用と保守を実現し、将来を見据えた無人ロボットによる自動的な運用と保守の進化を支えています。FusionPoD 720は、高密度、高性能、高エネルギー効率、高信頼性、統合デリバリー、簡素化されたO&Mなどの特長を備え、クラウドコンピューティング、仮想化、ビッグデータ、科学技術計算など、さまざまなシナリオに適し、エンタープライズ、インターネットデータセンター（Internet Data Center、IDC）、通信キャリア、インターネットなどのデータセンターに広く導入できます。

ハイライト



8倍に強化された高密度コンピューティングパワー

- 電力供給：業界をリードするN+1集中電力供給テクノロジー、および業界独自のCQCレベル6認証を取得した電源モジュール（Ultra-Titanium）を採用し、最大96.5%の変換効率を提供
- 放熱：高密度シャベルトウースコールドプレートにより、高電力チップの放熱要件を満たす
- データ通信：高速パッシブケーブルバックプレーンを採用



究極のインテリジェンスを実現する3バス完全ブラインドメイティングと0ケーブルの設計

- 業界初の電源/ネットワーク/液体の3バスブラインドメイティング設計、キャビネット内0ケーブルの設計を採用
- ノードのブラインドメイティング、効率的なO&M：ノードのブラインドメイティングに対応し、将来を見据えた無人ロボットによる運用と保守を支援
- キャビネット丸ごと納品、オンサイト設置不要：生産ラインでの設置と試運転により、お客様の機械室へのキャビネット丸ごと納品とオンサイト設置不要を実現し、導入効率の倍増を実現
- RoTベースのセキュアブートに対応し、いつでもどこでもセキュリティを確保



pPUEが1.06と低く、完全に商用利用可能なネイティブ液体冷却設計

- ネイティブ液体冷却：穴のないリベットとノードの擁壁設計、および高効率コールドプレートとパッシブリアドア熱交換器（rear door heat exchanger、RDHx）を採用
- pPUEが1.06と低く、TÜV SÜD pPUE認証を取得
- テュフラインランドによって認定された10年間の信頼性：キャビネット全体の信頼性設計により、10年以上の耐用年数を実現し、業界初のテュフラインランド液冷漏れなし証明書を取得
- 大規模な商用利用が可能で、5万台を超えるノードがライブネットワークに導入されている

利用可能なスペース	46個のスロット 説明: スロット1～16と22～41: 標準の1U高さのサーバーノードスロット スロット17～21: 1.2U高さのスイッチスロット スロット42～43: 標準の1U高さのPDUスロット スロット44～46: 標準の1U高さの電源シェルフスロット
サーバーノード	36台の1Uノード
pPUE	- RDHx付き: pPUEが1.06と低い - RDHxなし: pPUE<1.2
管理モジュール	キャビネット管理モジュール - キャビネットPSUとセンサー、キャビネットレベルの液漏れ監視、キャビネットの資産管理などに対応
環境仕様	- 動作温度: 5° C～45° C (ASHRAE Class A1/A2/A3/A4準拠) - 保管温度 短期保管温度(≤72h): -40° C～+70° C 長期保管温度(>72h): 21° C～27° C 最大温度変化率: 20° C/h
相対湿度 (RH、結露なし)	- 動作湿度: 8%～90% - 短期保管湿度(≤72h): 5%～95% - 長期保管湿度(>72h): 30%～69% - 最大湿度変化率: 20%/h
スイッチスロット	最大5つのスイッチスロットに対応 - スロット19 は、最大3台のカスタマイズスイッチ(2台のカスタマイズサービススイッチと1台のカスタマイズ帯域外管理スイッチ)をサポート - スロット17/18/20/21の各スロットは、1台の標準の1U高さのサードパーティ製10GE/25GE/100GEスイッチ、または2台のサービススイッチをサポート
配電	- 2N電力供給システム - 集中電力供給 - 12台のPSU(PSUあたり3kW) - N+1またはN+2冗長対応のPSU - 2+2三相交流電源入力 - 電圧範囲: 346V AC～415V AC
認証	CE、UL
フル搭載時の重量	1225Kg
寸法 (幅×高さ×奥行)	- RDHx付きでキャスターなしのキャビネット: 600mm×2200mm×1225mm - RDHxとキャスター付きのキャビネット: 600mm×2250mm×1225mm - RDHxとキャスターなしのキャビネット: 600mm×2200mm×1175mm - RDHxなしでキャスター付きのキャビネット: 600mm×2250mm×1175mm

ラックスケールサーバー

DH122E V6

概要



DH122E V6

DH122E V6は1U液冷サーバーノードです。システムのコンピューティング密度を高めるために革新的に設計され、高いコンピューティングパフォーマンス、高い液冷比、容易な管理、容易なO&Mなどの特長を備えています。データセンター、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、インターネットなどの高密度運用シナリオに適します。

技術仕様

プロセッサ	2×最大300Wの第3世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ（インテルWhitleyプラットフォーム全シリーズIce Lakeプロセッサ）
チップセット	Intel® C621A
メモリー	最大32×DDR4メモリー、または最大16×DDR4メモリー（メモリー液体冷却構成時）
ローカルストレージ	さまざまなハードディスク構成に対応（ハードディスクがホットスワップ対応）： 最大2×SAS/SATAハードディスク+10×SAS/SATA/NVMeハードディスク
RAIDサポート	RAID0、1、10、5、50、6、60に対応し、スーパーキャパシタによるキャッシュデータの電源障害保護、RAIDレベルの移行、ディスクローミング、自己診断、Webによるリモート設定などの機能を提供
ネットワーク	複数タイプのネットワーク拡張機能に対応：必要に応じて1枚のOCP 3.0 NICを構成可能
PCIe拡張	4×PCIeスロットに対応：1×RAIDコントローラカード専用のPCIeスロット、3×標準PCIe 4.0スロット
ファンモジュール	7×ホットスワップ対応の二重反転ファンモジュール、N+1冗長対応
コールドプレート	1×液冷プレートを構成可能。オプション仕様： <ul style="list-style-type: none">2×CPU+VRD液冷（液冷比率が最大65%に達する）2×CPU+16×DIMM+VRD液冷（液冷比率が最大80%に達する）
電力供給	1×DC電源モジュールを構成可能。オプション仕様： <ul style="list-style-type: none">1600W電源モジュール3000W電源モジュール
管理	iBMCチップは、1つの管理用GEネットワークポートを統合しており、故障診断、自動O&M、ハードウェアセキュリティ強化などの包括的な管理機能を提供 <ul style="list-style-type: none">iBMCは、Redfish、SNMP、IPMI 2.0などの標準インターフェースに対応し、HTML5/VNC KVMに基いたリモート管理ユーザーインターフェースを提供し、監視、診断、設定、エージェントレス、リモートコントロールなどの、管理の複雑さを簡素化する帯域外管理機能をサポートオプションのFusionDirector管理ソフトウェアは、5つのインテリジェントテクノロジーなどの高度な管理機能を提供し、ライフサイクル全体にわたるインテリジェント化・自動化・視覚化・洗練された管理を実現
OS	Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、Oracle、Ubuntu、Debian、openEuler
セキュリティ特性	パワーオンパスワード、管理者パスワード、TPM 2.0、セキュアブート
動作温度	5° C~45° C（ASHRAE Class A1/A2/A3/A4準拠）
認証	CE、UL
寸法（高さ×幅×奥行）	43.2mm×536mm×900mm

ラックスケールサーバー

DH120E V7

目 概要



DH120E V7

DH120E V7は、インターネット、インターネットデータセンター（Internet Data Center、IDC）、クラウドコンピューティング、エンタープライズと電気通信サービスの運用などのニーズに応じて開発した、幅広く利用されている次世代の1U2ソケット液冷サーバーノードです。柔軟な拡張性、高性能、高信頼性、容易な管理、容易な導入などのメリットを備え、ITコア業務、クラウドコンピューティング、仮想化、科学技術計算、エンタープライズまたは電気通信サービスの運用、およびその他の複雑なワークロードに適します。

目 技術仕様

プロセッサ	2×最大350Wの第4世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ（インテルEagle Streamプラットフォーム全シリーズSapphire Rapidsプロセッサ）
チップセット	Emmitsburg PCH
メモリー	最大32×DDR5メモリー
ローカルストレージ	さまざまなハードディスク構成に対応（ハードディスクがホットスワップ対応）：最大12×SAS/SATA/NVMeハードディスク
RAIDサポート	RAID0、1、10、5、50、6、60に対応し、スーパーキャパシタによるキャッシュデータの電源障害保護、RAIDレベルの移行、ディスクローミング、自己診断、WebIによるリモート設定などの機能を提供
ネットワーク	複数タイプのネットワーク拡張機能に対応： 最大4×ハーフハイトハーフレンジス（HHHL）の標準ネットワークカードスロット（必要に応じて構成可能）
PCIe拡張	最大4×PCIe 5.0 x16 HHHLスロット+1×PCIe RAIDコントローラカード専用のHHHLスロット/1×自社開発のRAIDコントローラカード専用のスロット
ファンモジュール	7×ホットスワップ対応の二重反転ファンモジュール、N+1冗長対応
コールドプレート	2×CPU+VRD液冷
電力供給	1×3000W DC電源モジュール
管理	サーバーノードのBMC管理システム
OS	SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux、VMware ESXi、Ubuntu
セキュリティ特性	管理者パスワード、TPM 2.0、セキュアブート
動作温度	5° C～45° C（ASHRAE Class A1/A2/A3/A4準拠）
認証	CE、UL
寸法 （高さ×幅×奥行）	43.2mm×536mm×900mm

xFusion技術日本株式会社

代表電話番号: 03-6206-7368

住所: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 17階

Webサイト: <https://www.xfusion.com/jp/>

Copyrights © xFusion Digital Technologies Co., Ltd 2023. All rights reserved.

書面によるxFusion Digital Technologies Co., Ltd.の事前承諾なしに、本書のいかなる部分も、いかなる形式またはいかなる手段によっても複製または転載することを禁じます。

商標および許諾

xFUSION およびその他のxFusionの商標は、xFusion Digital Technologies Co., Ltd.の登録商標です。このドキュメントに記載されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

注意

本書において、簡潔な説明と容易な理解のために「xFusion」は「xFusion Digital Technologies Co., Ltd.」を指すものとして使用されていますが、「xFusion」が他の意味を持つことを意味するものではありません。本書で記載または記載されている「xFusion」は、「xFusion Digital Technologies Co. Ltd.」以外の意味として理解されてはならず、「xFusion」の使用から生じるいかなる責任も負わないものとします。

ご購入の製品、サービスおよび機能はxFusion Digital Technologies Co., Ltd.とお客様の間の契約によって規定されます。本文書に記載されている製品、サービスおよび機能の全体または一部は、購入範囲もしくは使用範囲に含まれない場合があります。契約で別途許諾している場合を除き、本文書内の記述、情報、推奨事項はすべて「無保証 (ASIS)」で提供されており、明示的または暗黙的ないかなる保証も約束も行いません。

本文書の記載内容は、予告なく変更されることがあります。この文書の作成にあたっては、内容の正確性には最大限の注意を払っておりますが、この文書内のいかなる説明、情報、推奨事項も、明示的または暗黙的に何らかの保証を行うものではありません。